

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
【発行日】平成28年3月3日 (2016.3.3)

【公開番号】特開2014-179473(P2014-179473A)  
【公開日】平成26年9月25日 (2014.9.25)  
【年通号数】公開・登録公報2014-052  
【出願番号】特願2013-52630(P2013-52630)  
【国際特許分類】

**H 0 5 K      3/46      (2006.01)**

【 F I 】

H 0 5 K      3/46      H

H 0 5 K      3/46      S

【手続補正書】

【提出日】平成28年1月19日 (2016.1.19)

【手続補正 1 】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 0 1 】

本発明は、セラミック基板の製造方法および導体材料に関する。